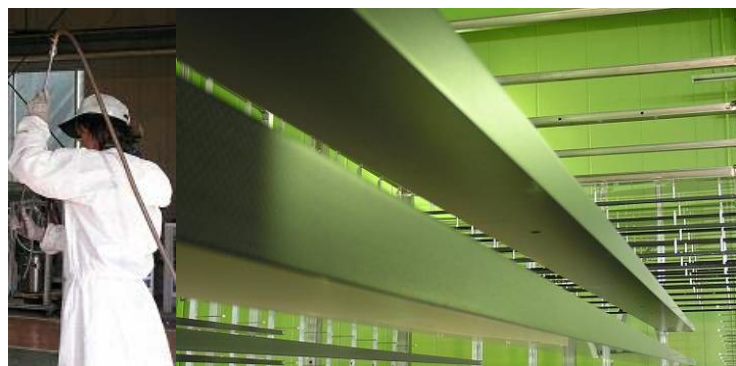


---

# 2009年3月期 第2四半期決算説明会

---

平田機工株式会社 2008.11.14



The Global Production Engineering Company  
**Hirata**

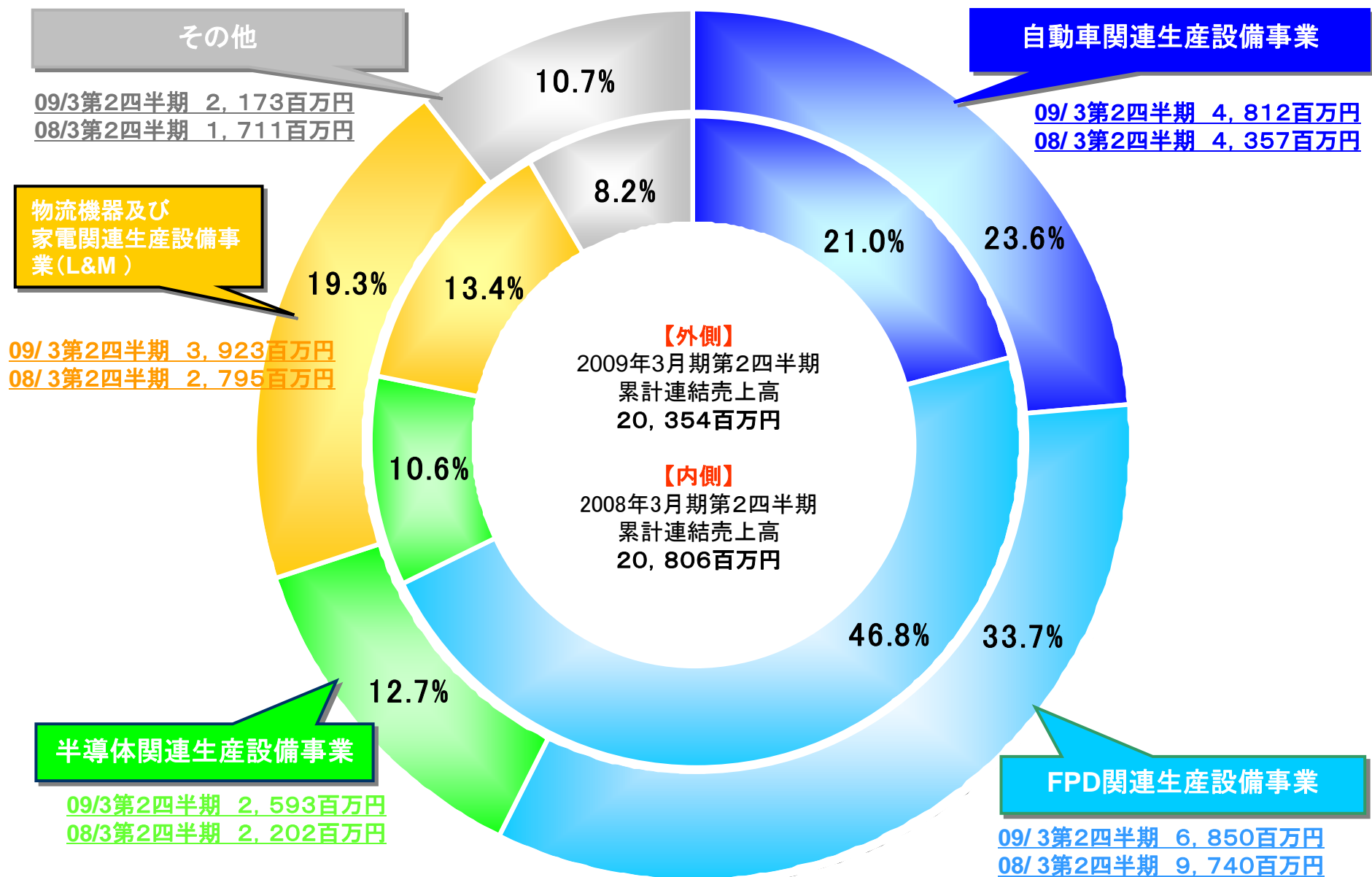




## I 第2四半期決算状況

2009年3月期 第2四半期（2008年9月30日）

# I 第2四半期決算状況 事業部門別売上高構成比



# I 第2四半期決算状況 決算概要

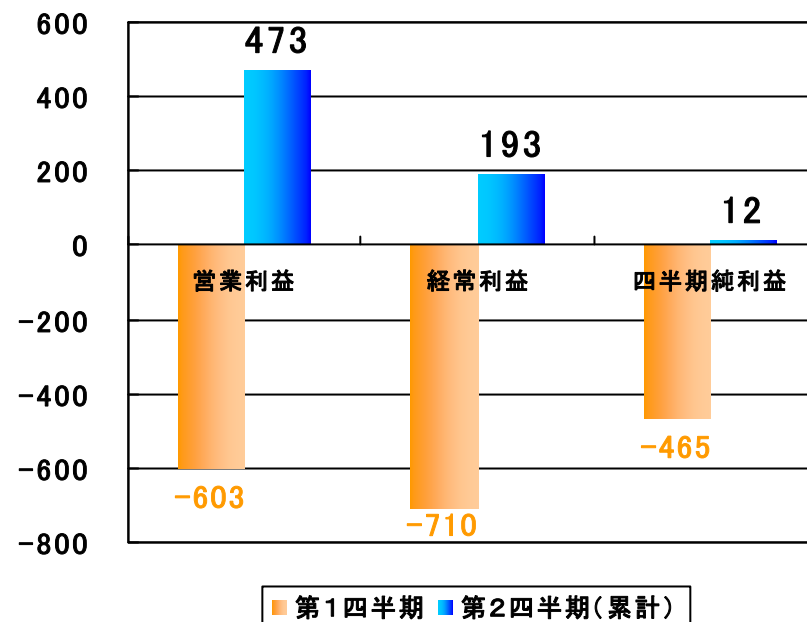
## 第2四半期 連結決算概要

(単位:百万円)

	2008年 3月期 第2Q 累計実績	2009年3月期 第2四半期累計				前年 同期比 増減率
		当初 計画	修正 計画	実績	達成率 (対当初 計画)	
売上 高	20,806	22,500	20,600	20,354	90.5%	▲2.2%
営業 利益	1,663	700	450	473	67.6%	▲71.5%
経常 利益	1,576	500	230	193	38.7%	▲87.7%
四半期 純利益	648	250	100	12	5.0%	▲98.1%

## 対第1四半期連結損益比較

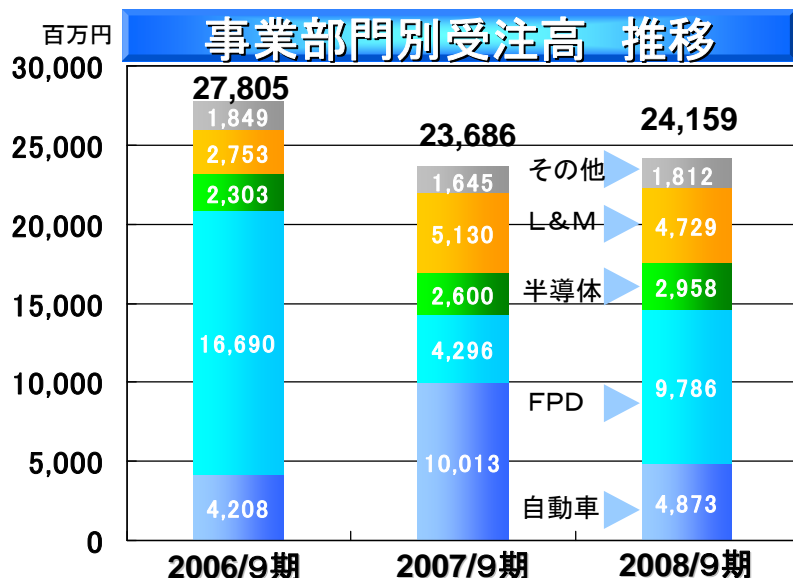
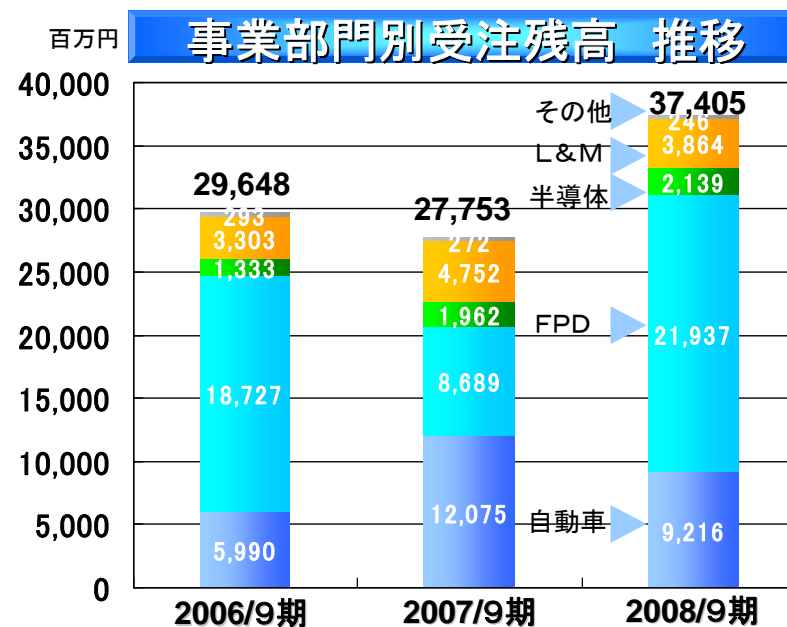
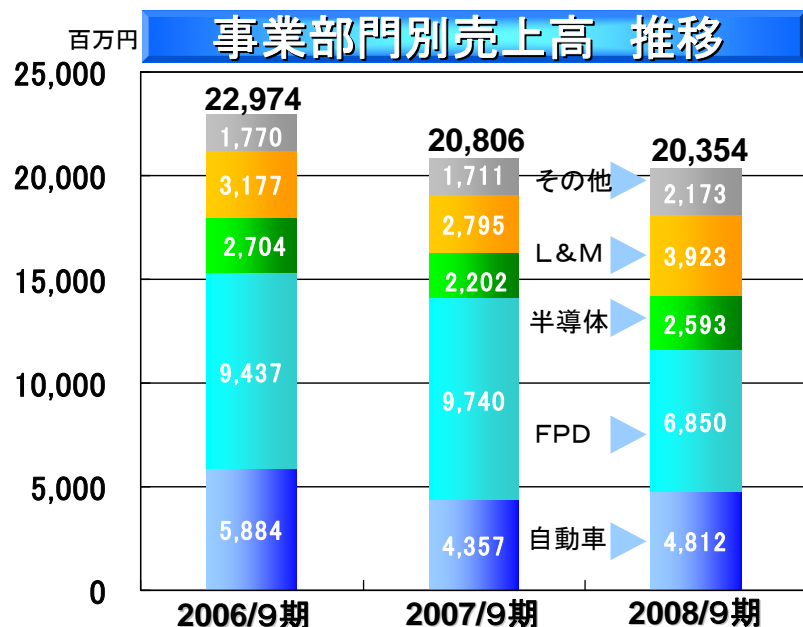
(単位:百万円)



■売上高は対前年同期比微減の水準となり、第1四半期に計上した損失は黒字転換。

■対計画比では売上高は90.5%の達成率。製造費用の増加等により利益は計画を大幅に下回った。

# I 第2四半期決算状況 事業部門別状況

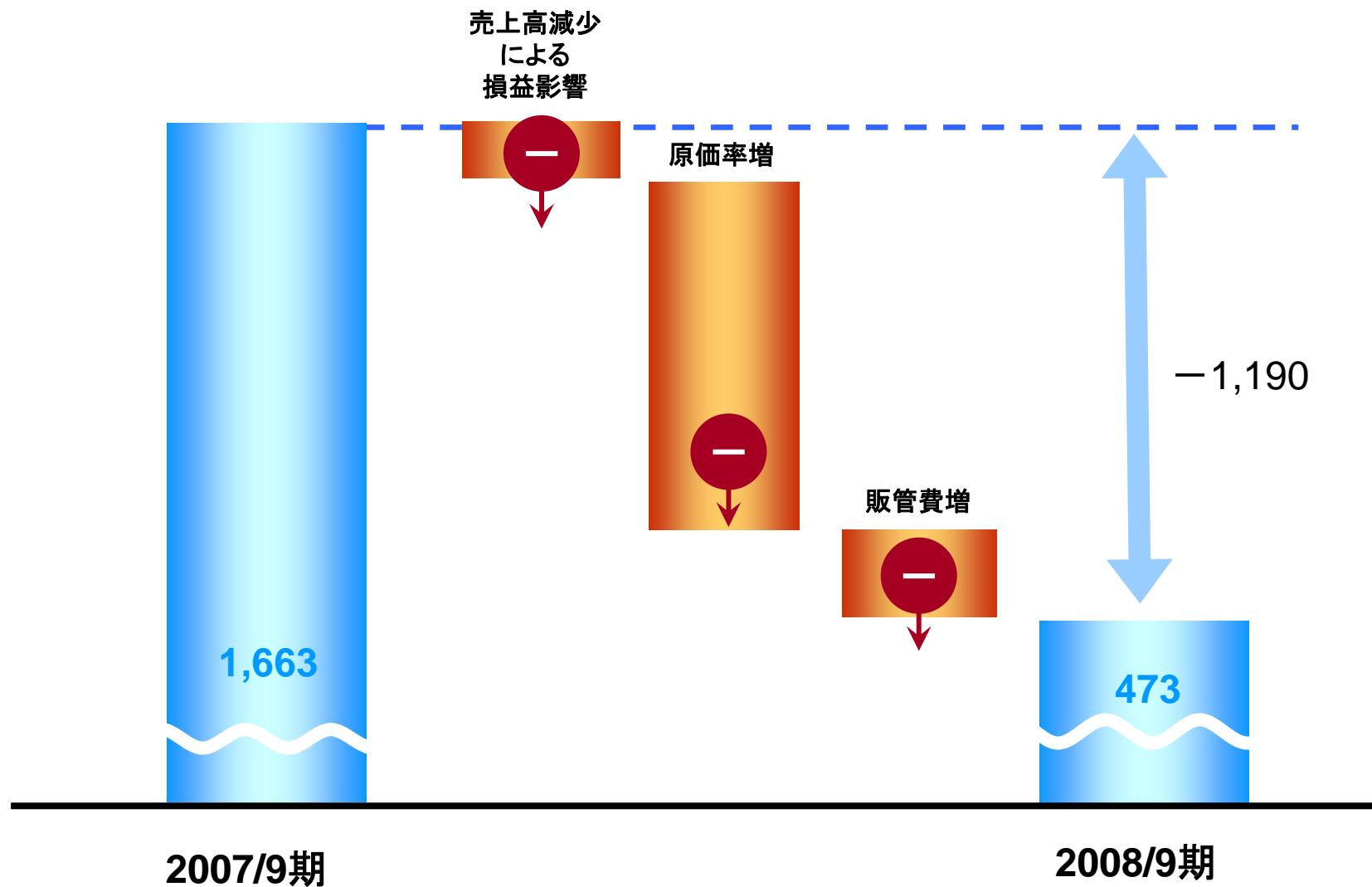


## 事業部門別状況

- 第2四半期累計期間の比較ではやや減収。
- 受注はFPD関連を中心に堅調。
- 受注残もFPD関連の積み増しにより増加。

# I 第2四半期決算状況 営業利益の増減要因分析

(単位:百万円)



# I 第2四半期決算状況 事業部門別連結売上高

■自動車関連生産設備、半導体関連生産設備、L&M関連生産設備はそれぞれ増収。  
FPD関連のみ減収。

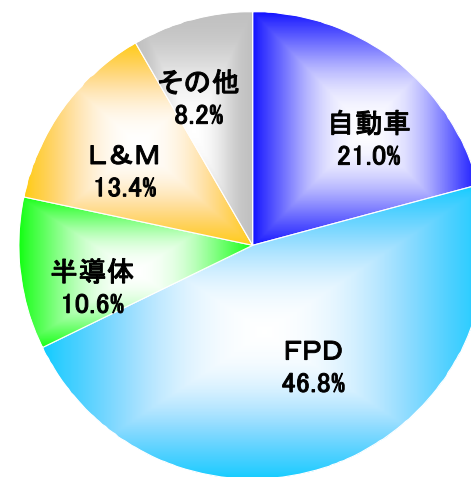
- ・自動車関連設備：北米向け大口案件、国内向け部品関連設備等で増収(+10.5%)
- ・FPD関連設備：第1四半期の売上不足を第2四半期で補いきれず減収(▲29.7%)
- ・半導体関連設備：市場全体は低調ながら大口案件の売上計上で増収(+17.0%)
- ・L&M関連設備：タイヤ関連などが堅調(+40.4%)

## 事業部門別売上高の状況

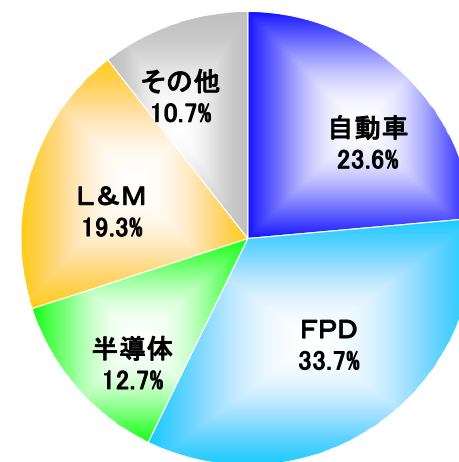
単位：百万円

事業部門	2008/3 第2四半期 累計	2009/3 第2四半期 累計	前年同期比 増減
自動車	4,357	4,812	+10.5%
FPD	9,740	6,850	▲29.7%
半導体	2,202	2,593	+17.8%
L&M	2,795	3,923	+40.4%
その他	1,711	2,173	+27.1%
合計	20,806	20,354	▲2.2%

2008/3 第2四半期累計



2009/3 第2四半期累計



# I 第2四半期決算状況 地域別連結売上高

■アジアは各事業部門の売上により大幅増加。  
北米は自動車関連生産設備の売上により増加。欧州はテレビ関連一服により減少。

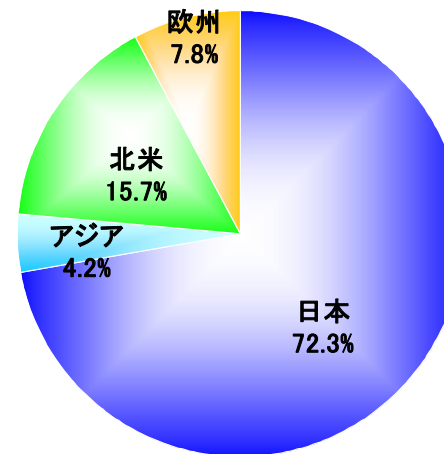
- ・ 国内向け: FPD関連生産設備が減収(▲17.0%)
- ・ アジア地域向け: 半導体以外の各事業部門が好調(+319.5%)
- ・ 北米向け: 自動車関連生産設備が増加(+16.5%)
- ・ 欧州向け: L&M関連生産設備で薄型テレビ関連が一服(▲73.9%)

## 地域別売上高の状況

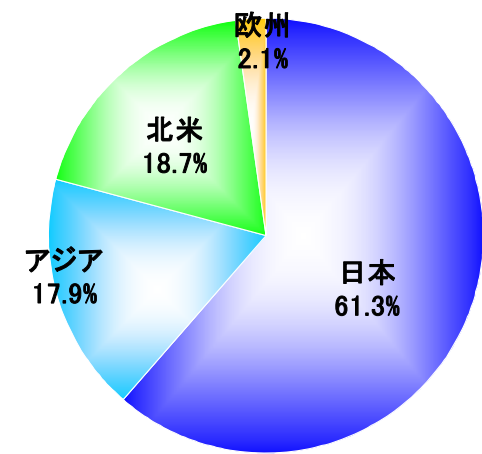
単位:百万円

地域	2007/3 第2四半期 累計	2008/3 第2四半期 累計	前年同期比 増減
日本	15,036	12,486	▲17.0%
アジア	866	3,636	+319.5%
北米	3,266	3,804	+16.5%
欧州	1,636	427	▲73.9%
その他	—	—	—
合計	20,806	20,354	▲2.2%

2008/3 第2四半期累計



2009/3 第2四半期累計





# I 第2四半期決算状況 事業部門別連結受注高

■ FPD関連生産設備は、大口案件の受注により大幅増。  
自動車関連、L&M関連は前年同期の堅調な受注高に比較すると減少。

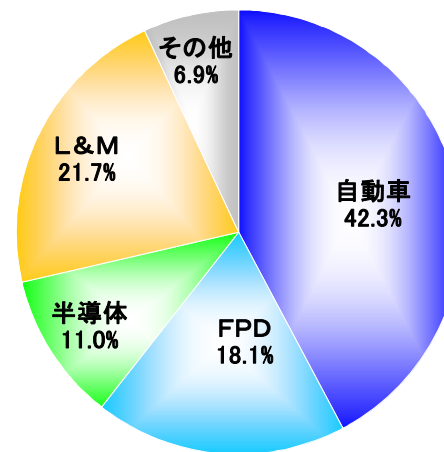
- ・ 自動車関連設備：大口案件を受注した前年同期比では半減(▲51.3%)
- ・ FPD関連設備：大口案件の受注などにより大幅増(+127.8%)
- ・ 半導体関連設備：有機EL関連の一部大口案件受注により増加(+13.8%)
- ・ L&M関連設備：タイヤ関連を中心に、微減(▲7.8%)

## 事業部門別受注高の状況

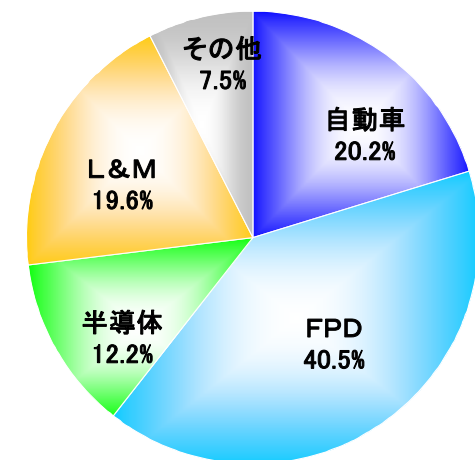
単位：百万円

事業部門	2008/3 第2四半期 累計	2009/3 第2四半期 累計	前年同期比 増減
自動車	10,013	4,873	▲51.3%
FPD	4,296	9,786	+ 127.8%
半導体	2,600	2,958	+ 13.8%
L&M	5,130	4,729	▲7.8%
その他	1,645	1,812	+ 10.2%
合計	23,686	24,159	+ 2.0%

2008/3 第2四半期累計



2009/3 第2四半期累計



# I 第2四半期決算状況 事業部門別連結受注残高

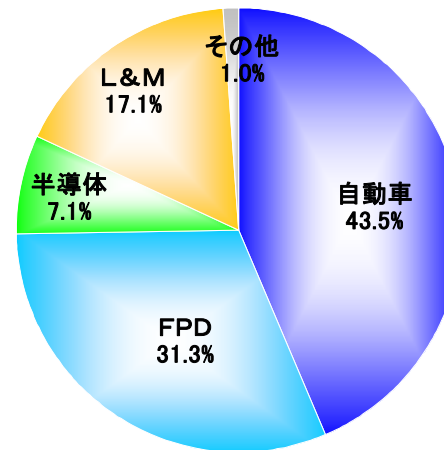
■ FPD関連生産設備は、大口案件の受注により大幅増。  
自動車関連生産設備は、大口案件の一部売上と受注減により減少。

- ・ 自動車関連設備：受注減少により減少(▲23.7%)
- ・ FPD関連設備：大口案件の受注により大幅増(+152.5%)
- ・ 半導体関連設備：市況悪化の中、受注活動強化により増加(+9.0%)
- ・ L&M関連生産設備：海外部門で減少(▲18.7%)

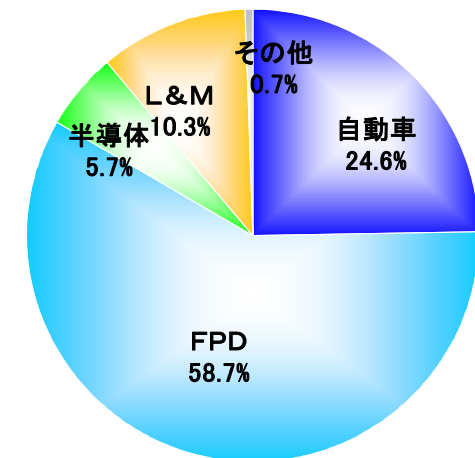
## 事業部門別受注残高の状況 単位：百万円

事業部門	2008/3 第2四半期	2009/3 第2四半期	前年同期比 増減
自動車	12,075	9,216	▲23.7%
FPD	8,689	21,937	+ 152.5%
半導体	1,962	2,139	+ 9.0%
L&M	4,752	3,864	▲18.7%
その他	272	246	▲9.6%
合計	27,753	37,405	+ 34.8%

2008/3 第2四半期



2009/3 第2四半期



## Ⅱ 今期のトピックス 今期4月～9月の主な施策・トピックス

### 海外戦略拠点の強化・拡充

- 中国現地法人が稼動
- 英国現地法人のプラハ支店開設

### 新製品の開発

- 自動車部品関連生産設備 ACS-C開発

ドイツ シュツットガルトで開催された国際組立・ハンドリング技術  
専門見本市MOTTEK2008に当製品を出展。好評を博した。

### 資本効率の向上

- 自己株式の取得



ACS-C



国際組立・ハンドリング技術専門  
見本市MOTTEK2008の当社ブース

---

## Ⅲ 事業の見通し

2009年3月期 第2四半期（2008年9月30日）



### Ⅲ 2007年3月期-2009年3月期中期経営計画

#### 中期経営計画と実績推移

※数値は単体ベース

	2007年3月期 実績	2008年3月期 実績	2009年3月期 予想	計画	達成率予想
売上高	39,575百万円	39,636百万円	42,000百万円	45,000百万円	達成率93%
営業利益率	6.8%	7.3%	2.3%	8.0%	達成率29%
有利子負債比率 (デット・エクイ ティ・レシオ)	0.97倍	0.88倍	1倍以下	1倍以下	達成率100%

#### ●計画の概要

生産リードタイムの短縮を成長ドライバーとして、売上げの拡大、営業利益率の改善、財務構成の向上を図ることで、持続的な成長を可能にする基盤をつくりあげる。

#### ●実績

事業環境の急激な変化のため、売上高、営業利益率とも未達成の見込み。組織的な経営体制の整備・強化などの基盤づくりは順調に進展。

#### ●次期中期経営計画

経営環境が大きく変化する中、それに迅速に対応し、成長を持続するための次期中期経営計画を策定中。

### Ⅲ 事業環境

世界的な金融不安が实体经济に波及し、景気減速が進む中、生産設備の需要動向についても不透明感が増大。

#### 自動車関連事業

国内及び欧米市場は、景気後退に伴い完成車の販売台数に急ブレーキ。各メーカーは、クリーンディーゼル、ハイブリッド等、環境対応車種の開発に注力。

#### FPD関連事業

TV用大型パネル需要の伸び率鈍化。パネル価格も引き続き低下。

#### 半導体関連事業

メモリー分野での投資減とデバイス価格の低迷により減少。

#### L&M関連事業

FPD下工程の投資は減速。  
タイヤ市場は北米・欧州では鈍化。新興国では堅調な成長が期待される。

### Ⅲ 今期連結業績予想

(単位:百万円、%)

	2008年3月期 実績	2009年3月期			
		上期(実績)	下期(予想)	通期(予想)	対前期比
売上高	47,237	20,354	29,645	50,000	+5.8%
自動車関連	11,167	4,812	8,687	13,500	+20.9%
FPD関連	17,561	6,850	13,449	20,300	+15.6%
半導体関連	5,183	2,593	2,607	5,200	+0.3%
L&M関連	9,878	3,923	3,276	7,200	▲27.1%
その他	3,445	2,173	1,627	3,800	+10.3%
営業利益(率)	3,177(6.7%)	473(2.3%)	706(2.4%)	1,180(2.4%)	▲62.9%
経常利益(率)	3,568(7.6%)	193(1.0%)	506(1.7%)	700(1.4%)	▲80.4%
当期純利益(率)	1,832(3.9%)	12(0.1%)	337(1.1%)	350(0.7%)	▲80.9%

### Ⅲ 今期の重点施策

---

前項までに述べた事業環境を踏まえ、期末に向けて以下の5点の重点施策を遂行することにより、収益確保及び更なる成長基盤の整備に努める。

1. 個別案件の採算性確保

4. 品質の向上

2. 生産性の向上

5. 受注の確保

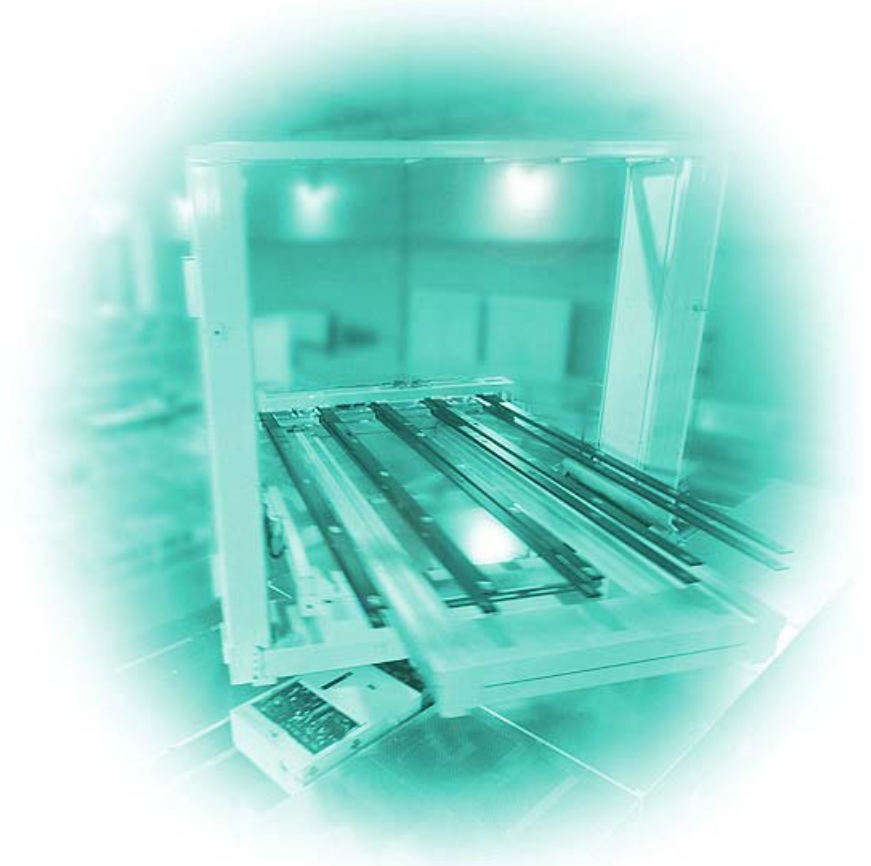
3. 調達機能の強化



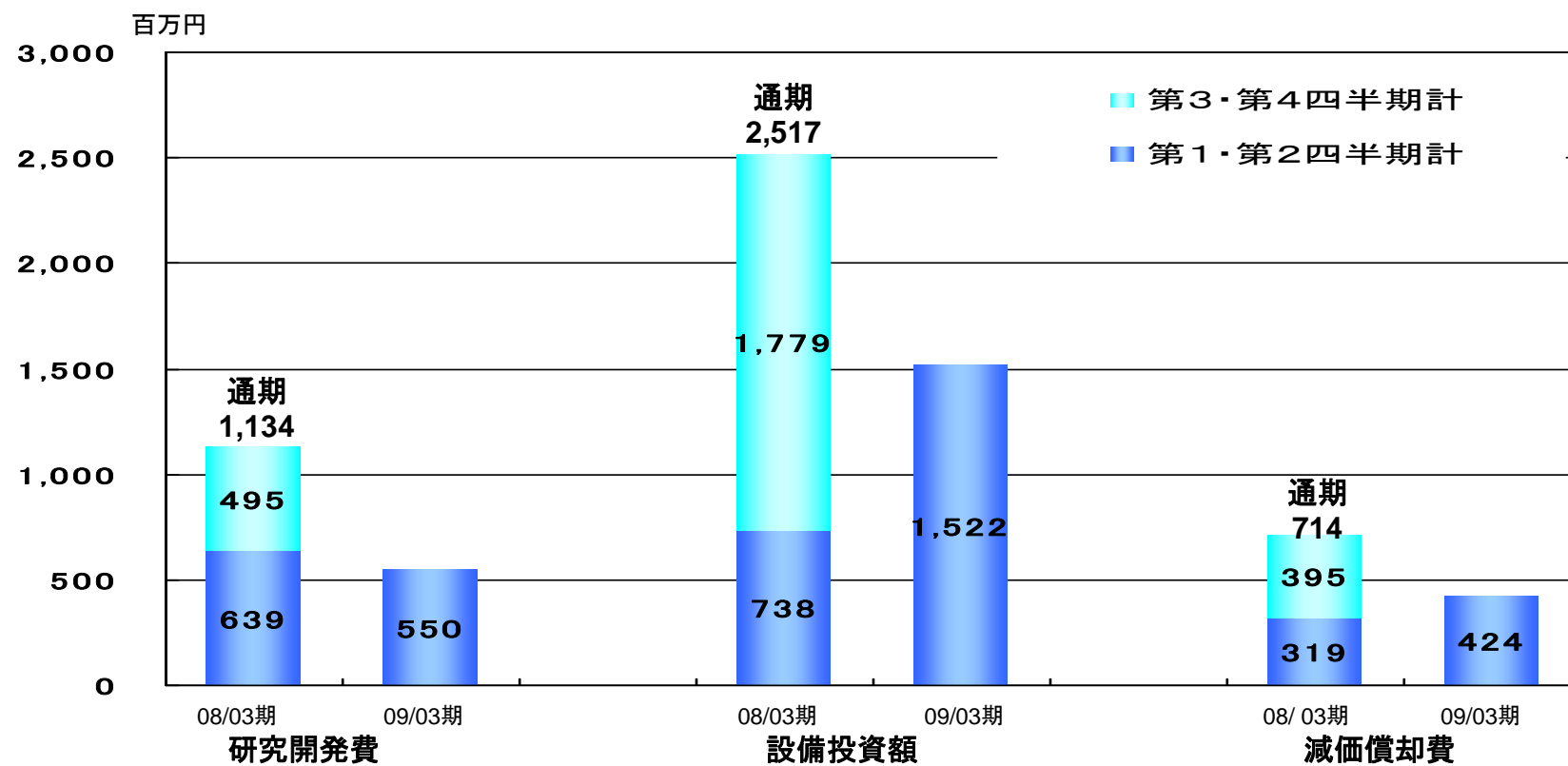
---

## IV 参考資料

2009年3月期 第2四半期（2008年9月30日）

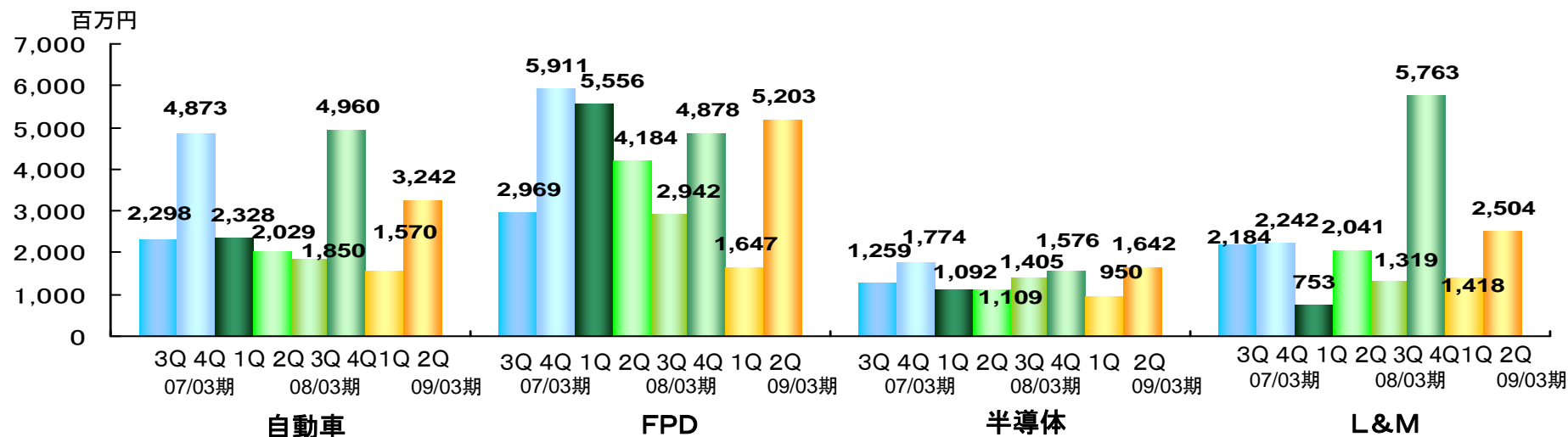


## IV 参考資料 研究開発費・設備投資額・減価償却費

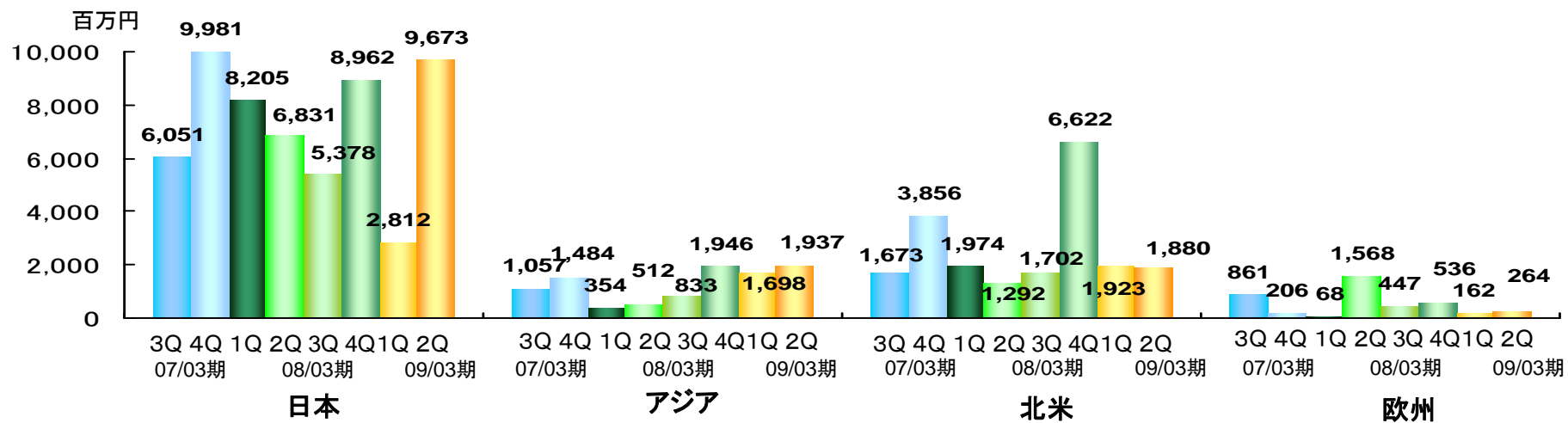


## IV 参考資料 事業部門別・地域別四半期推移(売上高)

### 事業部門別四半期売上高の推移

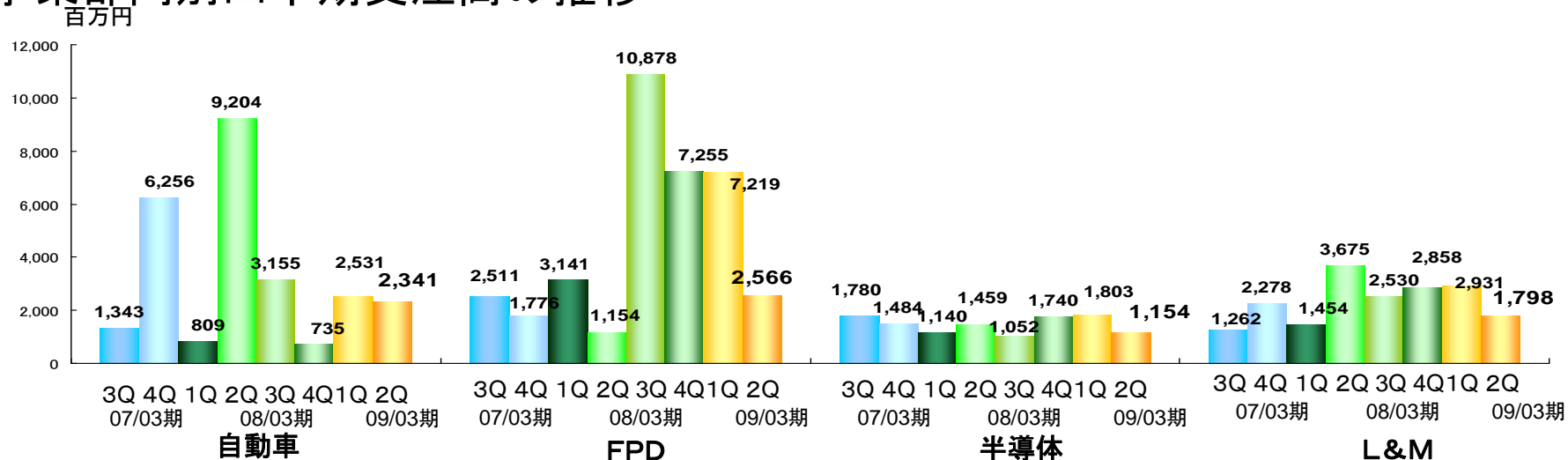


### 地域別四半期売上高の推移

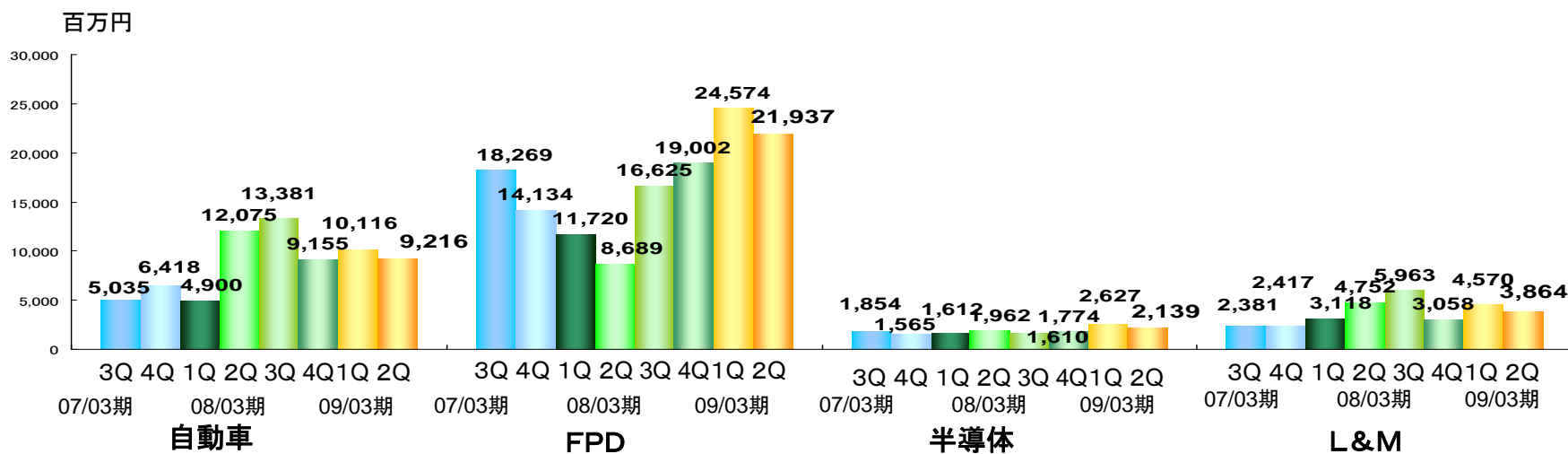


## IV 参考資料 事業部門別四半期推移(受注高・受注残高)

### 事業部門別四半期受注高の推移

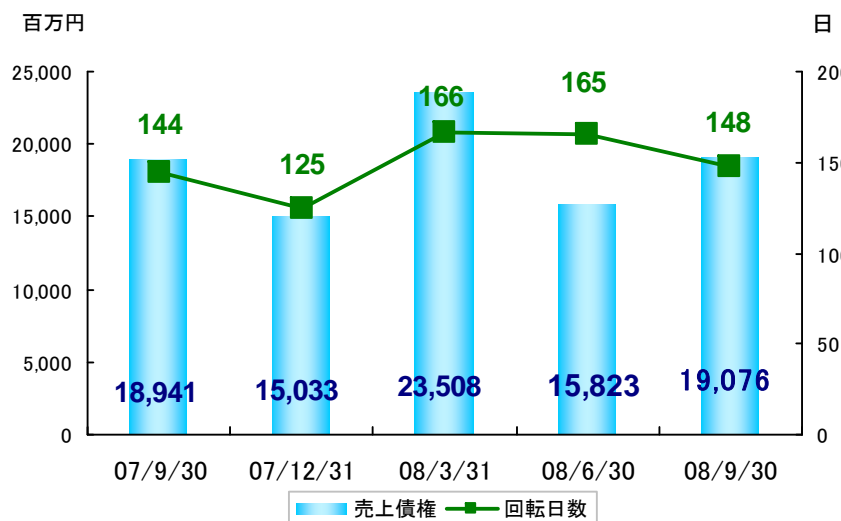


### 事業部門別四半期受注残高の推移

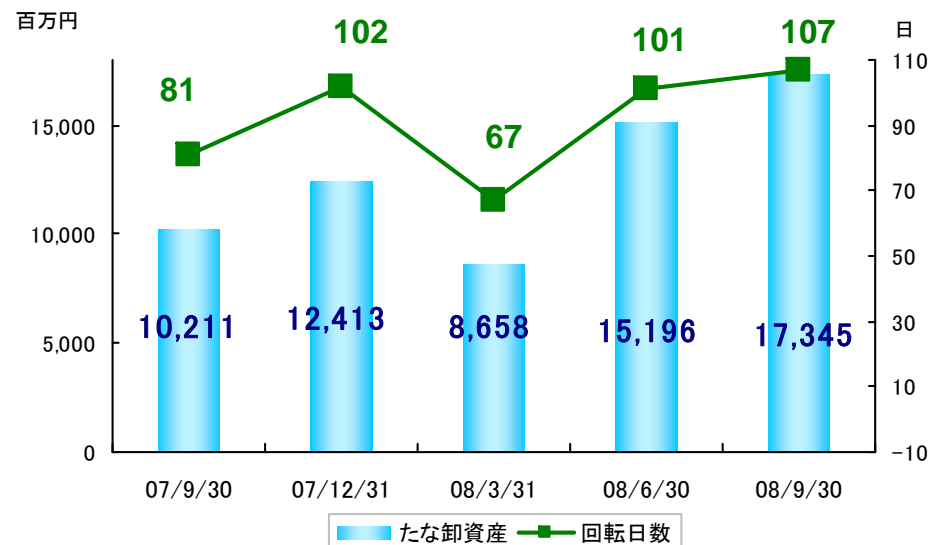


## IV 参考資料 主要指標

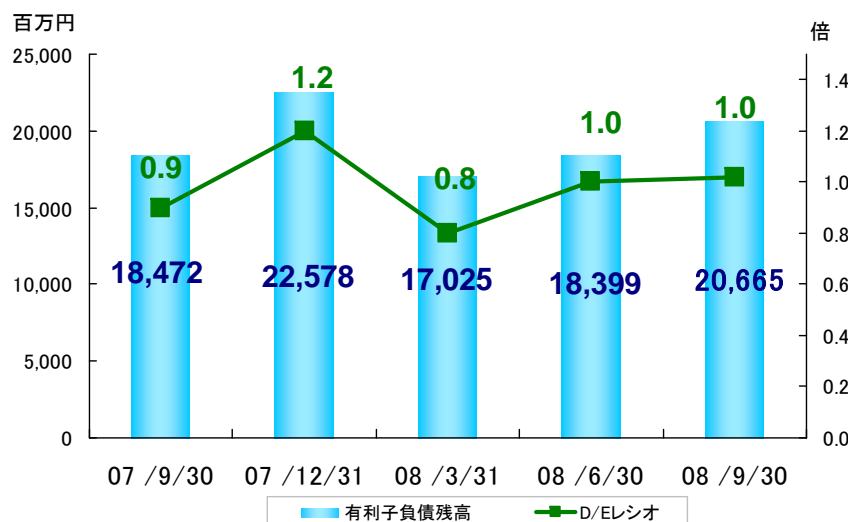
### 売上債権・売上債権回転日数



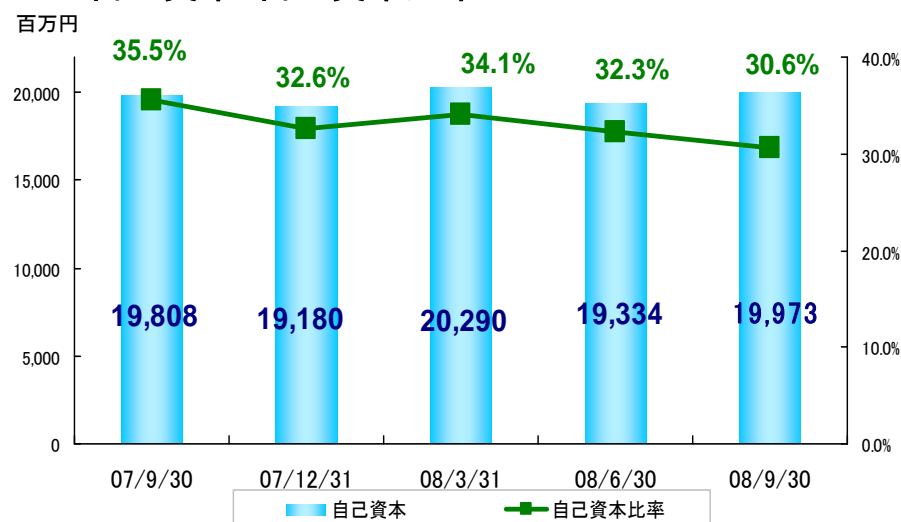
### たな卸資産・たな卸資産回転日数



### 有利子負債残高・D/ELシオ



### 自己資本・自己資本比率



本資料中の業績予想ならびに将来予測は、本資料作成時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、経済動向、他社との競争状況、為替レートなど潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、事業環境の変化等の様々な要因により、実際の業績は言及または記述されている将来見通しとは大きく異なる結果となることあることをご承知おきください。